

【原因・判断ポイント・発生工程】UTCのCF剥離時にUTC銅箔側に残った接着物が、ETレジストとなった為できたもの（UTC積層～ET工程）

【原因、判断要点、発生工序】在UTC的CF剥离时，UTC残留的粘性物成为ET剂所引起的（UTC层压～ET工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】Adhesive left on UTC foil after stripping carrier film of UTC acts as an etching resist to cause the defect. (UTC lamination - etching process)



【コメント】
顕微鏡倍率×175

【注釋】
显微镜倍率×175

【Comments】
Magnification: ×175

1-8-1-4 プリプレグ短絡／B片屑の短路／Short by prepreg debris

【特徴】多層板特有のもので、白っぽい樹脂異物下の銅箔残り短絡

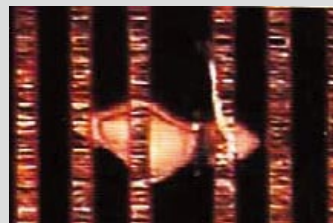
【特征】是多层板特有的，在铜箔下面有偏白色树脂杂物的残留的短路。

【Characteristics】Short by copper foil left under a whitish resin debris. Peculiar to multilayer boards

【原因・判断ポイント・発生工程】積層レイアップ工程で、銅箔表面に落下したプリプレグ屑が、積層工程で熱圧着され、これがETレジストとなった為に出来たもの（積層レイアップ～ET工程）

【原因、判断要点、発生工序】在预叠工序，B片屑掉落在铜箔表面，在层压工序被热压成为ET剂而引起的（预叠～ET工序）。

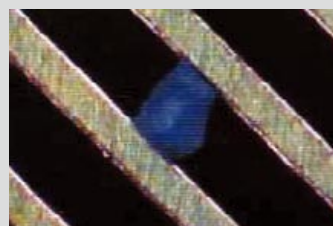
【Causes/processes involved/keys to judgment】A prepreg debris which drops onto the copper foil surface and is thermally adhered in a lamination lay-up process and acts as an etching resist, causing the defect. (Lamination lay-up - etching process)



【コメント】
顕微鏡倍率×

【注釋】
显微镜倍率×

【Comments】
Magnification: ×



【コメント】
プリプレグ樹脂の下に
積層銅箔が残っている
顕微鏡倍率×

【注釋】
层压铜箔下面残留的B
片屑
显微镜倍率×

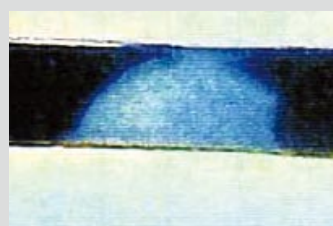
【Comments】
Laminate copper foil
left under prepreg
debris
Magnification: ×



【コメント】
顕微鏡倍率×

【注釋】
显微镜倍率×

【Comments】
Magnification: ×



【コメント】
プリプレグ樹脂の下に
積層銅箔が残っている
顕微鏡倍率×

【注釋】
层压铜箔下面残留的B
片屑
显微镜倍率×

【Comments】
Laminate copper foil
left under prepreg
debris
Magnification: ×